

L2 ANSWER 1 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 1997 DERWENT INFORMATION LTD
 AN 92-320122 [39] WPIDS
 DNN N92-244898 DNC C92-142311
 TI Copper alloy for electronic parts - contg. zinc, silicon, with tin and/or nickel and at least one of phosphorus, aluminium, iron, lead, arsenic, antimony etc..
 DC L03 M26 V04 X12
 PA (NIHA) NIPPON MINING CO
 CYC 1
 PI JP 04224645 A 920813 (9239)* 5 pp C22C009-04 <--
 ADT JP 04224645 A JP 90-414088 901226
 PRAI JP 90-414088 901226
 IC ICM C22C009-04
 ICS H01R013-03
 AB JP04224645 A UPAB: 931006
 Cu alloy including Zn 5-25%, Si 0.01-0.30%, additional (1) Sn 0.05-3.00% and/or Ni 0.05-3.00% by 0.05-6% in total and/or (2) at least one of P, Al, Fe, Pb, As, Sb, B, Co, Cr, Mn, Te, In, Ti, Zr, Hf, Be, Mg, Ag, Cd and Ge 0.001-2% in total, having crystal grain size less than 15 microns.
 O/O
 FS CPI EPI
 FA AB
 MC CPI: L03-A01A; L03-J; M26-B03; M26-B03N; M26-B03S; M26-B03T; M26-B03Z
 EPI: V04-D01; X12-D01A

Cu alloy a la master alloy

L2 ANSWER 2 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 1997 DERWENT INFORMATION LTD
 AN 91-262404 [36] WPIDS
 DNC C91-123868
 TI Prodn. of low strength copper alloy of fine grain size - by cold rolling specified amt. of metal, finish annealing then further cold rolling.
 DC M26
 PA (NIHA) NIPPON MINING CO
 CYC 1
 PI JP 03170646 A 910724 (9136)* <--
 ADT JP 03170646 A JP 89-306544 891128
 PRAI JP 89-306544 891128
 IC C22C009-04; C22F001-08
 AB JP03170646 A UPAB: 930928
 Cu-Zn alloy including at least one of Pb, Fe, Sn, Al, Mn, Ni, P, As, Te, Cr, Co, Zr, V, Be, Cd, Si, B, In, Ti, Mg, Hf and Ge 0.005 - 2.0% in total, is cold rolled by more than 75%, finish annealed to give grain size of less than 0.015 mm, and further cold rolled by 1 - 15% to improve soldability.
 O/2
 FS CPI
 FA AB
 MC CPI M26-B03; M26-B03Z; M29-B; M29-C

L2 ANSWER 3 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 1997 DERWENT INFORMATION LTD
 AN 91-152508 [21] WPIDS
 DNC C91-065969
 TI Copper alloy prodn. for radiator plate - by cold-rolling copper alloy, finish annealing and cold-rolling to specific grain size, etc..
 DC M21 M26 M29
 PA (NIHA) NIPPON MINING CO

BEST AVAILABLE COPY

(10) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平4-224645

(43) 公開日 平成4年(1992)8月13日

(51) Int.Cl. ³	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 2 2 C 9/04		6919-4K		
H 0 1 R 13/03	A	7331-5E		

審査請求 未請求 請求項の数5 (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平2-414088

(22) 出願日 平成2年(1990)12月26日

(71) 出願人 000231109

日本鉱業株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目10番1号

(72) 発明者 ▲つじ▼ 正博

神奈川県高座郡寒川町倉見三番地 日本鉱業株式会社倉見工場内

(72) 発明者 東江 民夫

神奈川県高座郡寒川町倉見三番地 日本鉱業株式会社倉見工場内

(74) 代理人 弁理士 小松 秀岳 (外2名)

(54) 【発明の名称】 電子部品用銅合金

(57) 【要約】

【構成】 Zn 5~25%, Si 0.01~3 %あるいはさらに Sn 0.05~3 %, Ni 0.05~3 %の1種又は2種を0.05~6 %含むもの、さらには上記両組成のそれぞれに、P, Al, Fe, Pb, As, Sb, B, Co, Cr, Mn, Te, In, Ti, Zr, Hf, Be, Mg, Ag, Cd, Geよりなる群より1種又は2種以上を 0.001~2 %含む銅合金である。

【効果】 本発明は強度、はんだ付け性、応力緩和特性、耐食性、耐応力腐食割れ性の改良された安価な電子部品用銅合金である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Zn 5～25重量%、Si 0.01～3 重量%を含有し、残部Cu及び不可避的不純物からなることを特徴とする電子部品用銅合金。

【請求項2】 Zn 5～25重量%、Si 0.01～3 重量%を含有し、更にSn 0.05～3 重量%、Ni 0.05～3 重量%の1種又は2種を0.05～6 重量%含み、残部Cu及び不可避的不純物からなることを特徴とする電子部品用銅合金。

【請求項3】 Zn 5～25重量%、Si 0.01～3 重量%を含有し、更に、P、Al、Fe、Pb、As、Sb、B、Co、Cr、Mn、Te、In、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ag、Cd、Geよりなる群より1種又は2種以上を0.001～2 重量%含み、残部Cu及び不可避的不純物からなることを特徴とする電子部品用銅合金。

【請求項4】 Zn 5～25重量%、Si 0.01～3 重量%を含有し、更にSn 0.05～3 重量%、Ni 0.05～3 重量%の1種又は2種を0.05～6 重量%含み、P、Al、Fe、Pb、As、Sb、B、Co、Cr、Mn、Te、In、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ag、Cd、Geよりなる群より1種又は2種以上を0.001～2 重量%含み、残部Cu及び不可避的不純物からなることを特徴とする電子部品用銅合金。

【請求項5】 結晶粒度が15 μ m以下である請求項(1)ないし(4)のいずれにか記載の電子部品用銅合金。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、トランジスタや集積回路(IC)などの半導体機器のリード材、コネクタ、端子、リレー、スイッチ等の電子部品用銅合金に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、半導体機器のリード材としては、熱膨張係数が低く、素子及びセラミックスとの接着及び封着性の良好なコパル(Fe-29Ni-16Co)、42合金(Fe-42Ni)などの高ニッケル合金が好んで使われてきた。しかし、近年、半導体回路の集積度の向上に伴い、消費電力の高いICが多くなってきたことと、封止材料として樹脂が多く使用され、かつ素子とリードフレームの接着も改良が加えられたことにより、使用されるリード材も放熱性のよい銅基合金が使われるようになってきた。

【0003】 一般に半導体機器のリード材としては以下のような特性が要求されている。

【0004】

(1) リードが電気信号伝達部であるとともに、パッケージング工程中及び回路使用中に発生する熱を外部に放出する機能を併せ持つことを要求されるため、優れた熱及び導電性を示すもの。

【0005】

(2) リードとモールドとの密着性が半導体素子保護の観点から重要であるため、リード材とモールド材の熱膨張係数が近いこと。

【0006】

(3) パッケージング時に種々の加熱工程が加わるため、耐熱性が良好であること。

【0007】

(4) リードはリード材を打ち抜き加工し、又曲げ加工して作製されるものがほとんどであるため、これらの加工性が良好なこと。

【0008】

(5) リードは表面に貴金属のメッキを行うため、これら貴金属とのメッキ密着性が良好であること。

【0009】

(6) パッケージング後に封止材の外に露出している、いわゆるアウターリード部に半田付けするものが多いので、良好な半田付け性を示すこと。

【0010】

(7) 機器の信頼性及び寿命の観点から耐食性が良好なこと。

【0011】

(8) 価格が低廉であること。

【0012】 これら各種の要求特性に対し、りん青銅及び若干の添加元素を加えた改良合金が広く使われてきた。しかし、近年、半導体に対する信頼度の要求がより厳しくなるとともに、小型化に対応した面付実装タイプが多くなってきたため、従来問題とされていなかった半田耐熱剥離性が非常に重要な特性項目となってきた。

【0013】

【課題を解決するための手段】 すなわち、リードフレームとプリント基板とが半田付けをされるが、使用中の温度及び通電による発熱により最高120℃程度までリードフレーム、及び半田付け部が温度上昇する。このような温度に長時間さらされると半田とリードフレームとの剥離が生じ、半導体が動作しない事が起こりえるため、寿命という観点から高信頼度が要求される場合、この半田耐熱剥離性は最も重要な特性の1つとなるわけである。とりわけ、FPP(FLATPLASTIC PACKAGE)やPLCC(PLASTIC LEADED CHIP CARRIER)に代表される面付実装タイプはプリント基板に装入するのではなく、面接触になるため、より半田耐熱剥離性が重要になってくるわけである。

【0014】 又、従来、電気機器用ばね、計測器用ばね、スイッチ、コネクタ等に用いられるばね用材料としては、安価な黄銅、優れたばね特性及び耐食性を有する洋白、あるいは優れたばね特性を有するりん青銅が使用されていた。この導電性ばね材の分野でも接触抵抗減、耐食性の向上等の理由でSn又は半田めっきが施され、又、半田付けが実施される事が多いため、先に述べ

【表1】

	No	化 学 成 分 (wt%)					
		Cu	Zn	Si	Sn	Ni	耐 成 分
本 発 明 合 金	1	残	8.2	0.5	—	—	—
	2	残	15.0	0.3	—	—	—
	3	残	11.5	0.6	—	—	Fe 0.1
	4	残	16.7	0.2	0.3	—	—
	5	残	14.4	0.2	0.3	—	Al 0.1
	6	残	19.1	0.2	—	0.2	—
	7	残	16.3	0.2	0.2	0.2	—
	8	残	12.5	0.3	0.2	—	Ti 0.1
	9	残	11.7	0.3	0.3	—	Co 0.1; Cr 0.1
	10	残	19.8	0.3	0.5	—	In 0.1; Mo 0.2
	11	残	15.0	0.4	0.2	0.1	P 0.01; Zr 0.1
	12	残	13.2	0.3	—	0.2	B 0.01; Mg 0.05
比 較 合 金	13	残	20.8	—	—	—	—
	14	残	31.3	—	—	—	—
	15	残	25.7	—	—	18.0	—
	16	残	—	—	8.2	—	P 0.12
	17	残	15.5	0.008	—	—	—

【0027】

【表2】

	引張強さ (kg/mm ²)	伸 び (%)	ばね限界値 (kg/mm ²)	導電率 (%IACS)	繰返し曲げ 回数(回)	応力緩和 率(%)	はんだ付け 性 *1	耐食性 *2	耐SCC性 (hr)
本 発 明 合 金	1	48.4	5.2	33.8	39	4.5	50	良好	153
	2	56.3	6.7	40.7	31	4.0	49	良好	59
	3	49.5	7.1	37.1	28	4.0	48	良好	104
	4	54.1	7.3	42.9	25	4.0	48	良好	67
	5	59.3	7.0	44.8	25	4.0	45	良好	72
	6	61.9	6.3	46.0	20	4.5	43	良好	35
	7	62.3	5.8	41.5	21	4.0	39	良好	74
	8	52.4	5.9	42.1	26	4.0	34	良好	90
	9	53.0	6.3	43.9	27	3.5	33	良好	33
	10	58.1	7.5	45.2	20	4.0	35	良好	19
	11	60.5	6.1	47.2	22	3.5	33	良好	71
	12	57.9	6.4	44.6	23	3.5	29	良好	82
比 較 合 金	13	49.3	5.2	35.4	33	4.5	49	良好	5
	14	58.2	6.1	45.8	28	4.5	45	不良	1
	15	60.5	6.4	50.7	6	4.6	14	不良	73
	16	59.7	27.6	17.1	13	5.5	35	良好	170
	17	52.8	6.5	37.5	38	4.5	51	良好	16

*1 良好: (濡れ面積95%以上)、不良: (濡れ面積約%未満)

*2 良好: (軽い全食腐食)、不良: (激しい腐食)

引張り強さ、伸びはJIS5号引張試験片を用い、テンシロン型引張試験機を使用し評価した。ばね限界値は幅10mmの短冊状に加工した試験片を用い、0.1mmの永久変形を与える曲げ応力を求めた。導電率は単位を%IACSで表わした。

【0028】繰返し曲げ性は幅0.5mmの端子状に加工した試験片の1端に225gのおもりをつけ、90°往復曲げを行い、破断までの回数を測定した。応力緩和特性は幅10mmの短冊状に加工した試験片に、0.2%耐力の80%の曲げ応力を負荷し、150℃、500時間加熱放置後の応力

緩和率を測定した。

【0029】はんだ付け性は230℃、6Sn/4Pbはんだ浴中に、ロジン-メタノールをフラックスとして使用し、表面を#1200エメリー紙により、研磨した試験片(0.25×10×50)を5秒間浸漬し、はんだの濡れ状況を調査した。

【0030】耐食性は25ppmのSO₂を含有する35℃、湿度95%の雰囲気中に試験片(0.15×40×60)を196時間暴露し、外観を観察した。

【0031】耐応力腐食割れ性(耐SCC性)は、トン

ブソン法にて、アンモニア雰囲気中で調査した。方法は、試験片(0.25×12.5×150)の両端部を結びループ状にし、24時間経過後、15%のアンモニア水を収容した乾燥箱内に暴露し、割れの発生するまでの時間を調査した。

【0032】これらの試験片はすべて圧延方向に平行方向に採取した。この表から本発明合金は、低級ばね材である丹銅より、強度、はんだ付け性、応力緩和特性、耐食性、SCC性にすぐれ、高価な洋白、りん青銅と遜色

ない特性値を有する安価な電子部品用銅合金であることがわかる。

【0-0-3-3】

【発明の効果】本発明の銅合金は、従来低級ばね材として使用されている丹銅(Cu-Zn系合金)にSiあるいはさらにSn、Niを添加することにより、強度、はんだ付け性、応力緩和特性、耐食性、耐応力腐食割れ性の改良された安価な電子部品用銅合金である。

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☒ **FADED TEXT OR DRAWING**

☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.